

THLC-S 系列在线式红外热像仪

操作简便、图像细腻、高稳定性

THLC-S 在线式红外热成像仪 可配备不同分辨率、高性能红外热成像机芯，由网线和电脑连接，将机芯输出的红外数字图像传输到后端 IRvisionResearch 软件。热像仪专门用于科研测温、生产检测、科研二次开发等工作。具画面细腻、测温灵活、使用便捷等特点。具有任意区域高峰、低峰温度追踪、长时间记录等功能。另具备各种 SDK 开发包，可供科研单位进一步研发应用。

该系统由以太网线连接，方便部署、操作人员易于上手。

- **热探测器：**使用高性能氧化钒(VOx)探测器，图像细腻、测温稳定。
- **连接方式：**前端热像仪使用网线与后端连接，布线方便，也可使用局域网进行远距离连接。
- **测温方式：**可任意选取测温区域进行测量，软件自动追踪区域内高峰、低峰温点位置并显示高峰、低峰与平均温度数值，并实时显示在软件界面中。同时软件可进行动态记录，将带温度信息的红外图像、温度数据、采样时间信息记录下来，供后期分析使用。
- **测量参数：**软件提供测温参数开放端口，可供前端任意进行辐射率、环境参数、大气透过率等矫正。
- **二次开发：**软件提供 SDK 开发包，开发人员只需要布置自己所需的界面与功能需求，各种底层通讯都已被制成函数库，可供调用，提高了科研单位的开发效率。拥有各平台 SDK 库，C++、C# 等。



THLC-S 规格参数

主要功能

探测器类型	非制冷红外热成像探测器, 响应波长:7.5-13.5 μ m , 测温型	
探测器规格	336 x256	640x512
可配镜头	9.7mm: 38°x29° 13mm: 28°x21° 19mm: 20°x15° 25mm: 15°x11°	9mm 69° x 56° 13mm 45° x 37° 19mm 32° x 26° 25mm 25° x 20°
测温精度	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或 2%	
测温范围	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +150 $^{\circ}\text{C}$, 0 $^{\circ}\text{C}$ ~ +550 $^{\circ}\text{C}$	
控制方式	网线连接 PC, 使用 PC 端软件控制	
软件主要功能	1、显示各种调色板下的红外图像; 2、划定任意区域, 软件自动跟踪高峰、低峰、平均温, 同步输出位置与数值; 3、按采样率连续记录红外数字图像、并记录所测温度信息 4、提供所有功能的 SDK 软件开发包, 供研发人员使用 SDK 开发平台: C++ ,C#等	
调色板类型	白热-黑热-铁红-彩虹-冰火等	
SDK 开发平台	C++ ,C# 等	

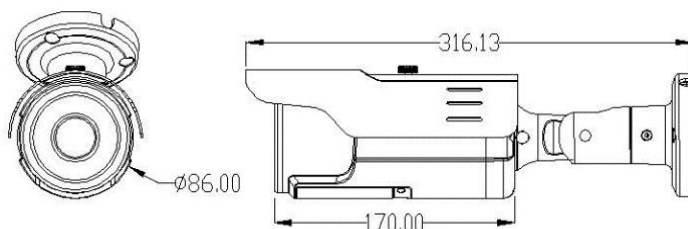
物理属性

外形尺寸 (参考)	316.13 x86mm(长 x 直径)	
接口	电气接口: 网线(RJ45) 、直流电源接口、I/O 输出接口 机械接口: 三孔安装圆盘, 可转接 1/4" 及 3/8" 三脚架接口	
供电	12V/DC	
工作环境	温度: -40 $^{\circ}\text{C}$ —70 $^{\circ}\text{C}$ /湿度: 5% —95%, 非冷凝	
运输环境	温度 : -45 $^{\circ}\text{C}$ —85 $^{\circ}\text{C}$ /湿度: 5% —95%, 非冷凝	
抗冲击	10g 冲击脉冲/11ms 锯齿波 (与系统封装有关)	

型号示例说明:

THLC-S313 表示 336 x 256 像素, 13mm 镜头

THLC-S619 表示 640 x 512 像素, 19mm 镜头



THLC-S 系列工程尺寸图